**Biz Networking for Co-Creation　2025　面談申請表**

（聯絡窗口E-mail：semicon@higobank.co.jp）

１．貴公司的簡介（**⑨、⑩為圈選題**）

|  |  |
| --- | --- |
| ①企業名稱 |  |
| ②所在地點 |  |
| ③ＴＥＬ |  | ④URL |  |
| ⑤資本額 |  | ⑥員工人數 | 名 |
| ⑦主要業務（產品） |  |
| ⑧聯絡窗口 | （姓名） | （部門） | （職稱） |
| （Mobile） | （E-mail） |
| ⑨當日使用語言※可複選 | 中文 | 英文 | 日文 |
| ⑩希望拓展業務的地區※可複選 | 日本 | 台灣 | ASEAN(東南亞國家協會) | 美國 |

請以附件提交其他關於「公司技術」・「銷售管道」・「交易對象」・「擁有設備」・「人員組成」等資訊 (樣式、語言不限。檔案格式PDF檔)。

２．出席者（請將欲參加項目及符合項目**打圈**）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 部門・職稱 | **第一部分****（商談會）** | **第二部分****（交流會）** | **素食者** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

※第二部分(交流會)為收費活動。每人2,000元新台幣（預計）。付款方式：活動現場以現金支付。

３.　 希望面談的企業（可複選）

※若希望面談的日本企業較多，可能無法完全滿足您的需求，敬請見諒。

 即使事前配對後未成功安排面談，預計仍可於自由交流區與企業進行洽談。

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 企業名稱
 |  |
| 1. 具體希望進行面談的理由
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 企業名稱
 |  |
| 1. 具體希望進行面談的理由
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 企業名稱
 |  |
| 1. 具體希望進行面談的理由
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 企業名稱
 |  |
| 1. 具體希望進行面談的理由
 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. 企業名稱
 |  |
| 1. 具體希望進行面談的理由
 |  |